WEEKLY REVIEW / 美股市场周评

长端利率回落 美股内部承压

参考风险敞口为 15%，半导体跌势仍未缓解

综合风险 · 暂定	参考风险敞口	SMH 近 20 个交易日
64.7	15%	−23.1%

Taiyang Feng (Sunny)

2026-11-08

权益截至 2026-11-06 · ACM 截至 2026-11-03

What remains persists.

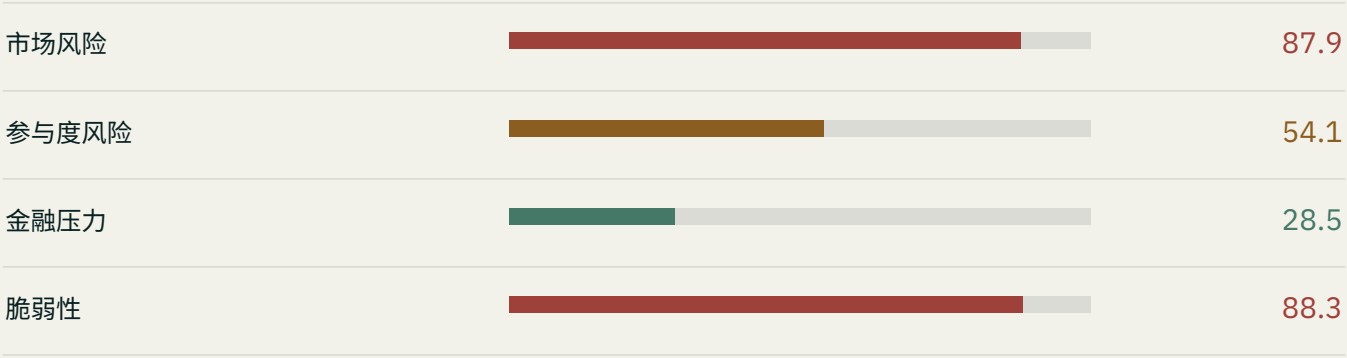
01 / MARKET REGIME

权益内部风险仍高

11 月 6 日，美股综合风险评分为 64.7，处于谨慎区间。市场风险为 87.9，脆弱性为 88.3，两项均处压力区。参与度风险为 54.1，处于谨慎区间。金融压力为 28.5，仍属建设性。

研究总览的综合广度仅为 44.2%，对应 10 月末两项广度指标的均值。官网 11 月 6 日的日频估计显示，约 43.1% 的股票位于 200 日均线上方。9 月末多空因子拥挤指标处于 L3，做多组合经贝塔调整后处于 L4。11 月 6 日，泡沫因子层的 HML 估值处在约第 94 历史分位，反映价值组合相对估值极低。Livermore S2 为 74.6，进入观察区，上涨动能衰竭值得关注。

芝加哥联储 10 月 30 日的 NFCI 与 ANFCI 分别为 −0.459 和 −0.435，差值为 −0.024。两项指数仍低于零，近四周均有所上升。结合本期金融压力评分，压力主要集中于股票市场内部，广泛的金融条件收紧尚未得到确认。



02 / SEMICONDUCTORS / AI HARDWARE

硬件综合分触底，原始分继续走弱

截至 11 月 6 日，半导体与 AI 硬件综合分仍为 0，原始分为 −34.2，低于上期的 −12.7。SMH 近 20 个交易日下跌 23.1%，落后 QQQ 约 10.4 个百分点。相较于综合分的显示下限，原始分和相对表现更能反映这段时间的进一步走弱。

28 只监测股票中，站上 20 日均线的比例约为 4%，站上 50 日均线的比例也约为 4%。需求动量与供应链确认均为 0。同期 NXPI 上涨 9.1%，而 MRVL、INTC 和 TER 分别下跌 48.7%、46.2% 和 45.8%。少数个股的韧性尚未扩散至板块。

硬件综合分 / 原始分	0 / −34.2
SMH 近 20 个交易日	−23.1%
站上 20 日 / 50 日均线	4% / 4%
需求动量 / 供应链确认	0 / 0

03 / TREASURY YIELDS

期限溢价主导长端利率回落

截至 11 月 3 日，纽约联储发布的 ACM 模型 10 年期美债拟合收益率为 4.922%，其中预期短端利率分项为 4.244%，期限溢价为 0.677%。各项水平按显示精度取整。

从 10 月 2 日到 11 月 3 日，拟合收益率下降 33.22 个基点。其中期限溢价贡献 −23.91 个基点，约占总降幅的 72%，预期短端利率分项贡献 −9.31 个基点。长端估值压力有所缓和，主要来自投资者持有长期国债所要求的补偿下降。

10 年期 ACM • 2026-10-02 至 2026-11-03

预期短端利率分项	−9.31 bp
期限溢价分项	−23.91 bp
拟合收益率净变化	−33.22 bp

04 / POSITIONING & DATA

维持低敞口，等待两项修复

周频风控模型 11 月 6 日发出信号，参考风险敞口为 15%，自 11 月 9 日起生效。该信号使用部分滞后输入。长端利率回落为估值提供一定缓冲，当前仍维持低风险敞口。

提高敞口前，观察市场广度能否持续扩大，以及半导体相对 QQQ 的表现能否企稳，并得到需求动量和供应链确认的共同支持。

本周调整了 HML 数据覆盖门槛及估算规则，综合模型仍采用 UMD 代理输入，其他分项取各自最近可用数据。64.7 为暂定估算，不能直接与旧模型版本的评分做周环比。15% 为模型参考敞口，实际持仓另行记录。

周频风控模型

15%

生效 2026-11-09

来源与披露

1. 本期冻结观察数据
2. 余势美股市场看板
3. 芝加哥联储金融条件指数
4. 纽约联储 ACM 期限溢价数据

本材料仅用于研究与信息交流，不构成投资建议。